



平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年10月28日

上場取引所 東

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 竹中 博司

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経理担当 (氏名) 七澤 豊

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 平成23年11月9日

配当支払開始予定日

平成23年12月1日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	326,350	2.5	36,859	△12.9	39,722	△11.9	26,657	△20.3
23年3月期第2四半期	318,400	106.9	42,342	—	45,107	—	33,454	—

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 20,048百万円 (△29.9%) 23年3月期第2四半期 28,588百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第2四半期	148.85	148.63
23年3月期第2四半期	186.88	186.60

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	782,467	591,219	74.0
23年3月期	809,205	584,801	70.8

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 579,266百万円 23年3月期 572,741百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	38.00	—	76.00	114.00
24年3月期	—	53.00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	27.00	80.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	630,000	△5.8	57,000	△41.8	60,500	△40.6	40,000	△44.4	223.31

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(その他)」に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(その他)」に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期2Q	180,610,911 株	23年3月期	180,610,911 株
② 期末自己株式数	24年3月期2Q	1,485,306 株	23年3月期	1,554,231 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期2Q	179,086,953 株	23年3月期2Q	179,018,068 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

・当社は、平成23年10月28日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	4
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	5
2. サマリー情報(その他)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表等	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(4) 継続企業の前提に関する注記	11
(5) セグメント情報等	11
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、欧州に端を発する金融市場の混乱により、米国をはじめとする先進国の景気低迷など、先行きの不透明感が高まっております。中国、インドなどの新興国においては引き続き内需を中心に拡大しておりますが、経済成長に減速感が出始めております。また、日本経済は円高の長期化や世界的な景気減速を受け、東日本大震災の影響からの回復は非常に緩やかになっております。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業に関しましては、テレビ、パソコン、携帯電話需要が停滞するなか、好調なスマートフォン等の情報端末機器の伸びに期待がかかるものの、電子部品市況を反転させるほどの動きにはなっておりません。

このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高3,263億5千万円(前年同期比2.5%増)、営業利益368億5千9百万円(前年同期比12.9%減)、経常利益397億2千2百万円(前年同期比11.9%減)、また、四半期純利益は266億5千7百万円(前年同期比20.3%減)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 半導体製造装置

ネット接続の主役がパソコンからスマートフォン等の携帯端末機器に徐々にシフトし、フラッシュメモリーやプロセッサ需要の高まりが期待されたもののやや力強さに欠け、一方でパソコンの販売不振による影響が顕著であり、生産調整に入った半導体メーカーの設備投資が減速しました。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2,483億9千4百万円(前年同期比3.4%増)となりました。

② FPD/PV (フラットパネルディスプレイ及び太陽電池) 製造装置

スマートフォン向け等の旺盛な中小型液晶パネル需要を受け、パネルメーカーによる大型液晶パネルラインの中小型向けラインへの切り替えが進みつつあります。一方、先進国における消費不振等を背景にテレビ需要は世界的に振るわず、製造装置の受注は低調でした。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、366億7千7百万円(前年同期比11.6%増)となりました。

③ 電子部品・情報通信機器

パソコンやテレビをはじめとするデジタル家電関連の需要が総じて減退しており、これに伴い半導体や電子部品は在庫調整の局面となっております。コンピュータシステム関連分野に関しましては、クラウドコンピューティングやデータセンターの利用に対して関心が高まりつつある状況となっております。この結果、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、410億3千7百万円(前年同期比9.0%減)となりました。

④ その他

当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2億4千1百万円(前年同期比3.1%増)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期	当期上半期	
			当期第1Q	当期第2Q
売上高	318,400	350,321	326,350	173,232
半導体製造装置	240,229	271,101	248,394	127,557
日本	46,952	40,988	50,365	29,421
米国	40,026	62,871	53,579	23,823
欧州	9,970	18,511	30,988	16,988
韓国	51,571	36,287	37,883	20,957
台湾	71,097	79,185	44,163	19,458
中国	9,844	15,748	15,800	6,685
東南アジア他	10,766	17,509	15,613	10,222
FPD／PV製造装置	32,860	33,860	36,677	24,141
電子部品・情報通信機器	45,075	45,140	41,037	21,388
その他	234	218	241	145
営業利益	42,342	55,528	36,859	13,770
経常利益	45,107	56,812	39,722	15,970
四半期純利益	33,454	38,470	26,657	10,021

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

【生産及び受注の実績】

1. 生産実績

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期	当期上半期	
			当期第1Q	当期第2Q
半導体製造装置	238,071	269,090	232,433	105,286
FPD／PV製造装置	37,955	36,061	29,957	15,841
合計	276,026	305,151	262,390	121,127

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注実績(受注高)

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期	当期上半期	
			当期第1Q	当期第2Q
半導体製造装置	283,484	284,487	186,224	73,531
FPD／PV製造装置	33,891	41,542	10,633	1,713
電子部品・情報通信機器	47,602	43,433	42,092	19,584
その他	234	218	241	145
合計	365,212	369,681	239,192	94,974

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績(受注残高)

(単位：百万円)

	前期第2Q末	前期期末	当期第1Q末	当期第2Q末
半導体製造装置	215,557	228,942	220,798	166,773
F P D / P V 製造装置	57,809	65,491	61,875	39,447
電子部品・情報通信機器	16,082	14,375	17,235	15,430
その他	—	—	—	—
合計	289,449	308,809	299,909	221,651

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 財政状態

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ343億2千4百万円減少の6,099億7百万円となりました。主な内容は、未収消費税等の減少107億6千4百万円、たな卸資産の減少97億3千万円、有価証券に含まれる短期投資の減少85億5千8百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から102億5千8百万円増加し、1,228億1千万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から1億4千4百万円減少し、40億6千8百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から25億2千7百万円減少し、456億8千1百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から267億3千7百万円減少の7,824億6千7百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ348億9千1百万円減少の1,331億4千6百万円となりました。主な内容は、未払法人税等の減少182億円、支払手形及び買掛金の減少117億5百万円であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ17億3千6百万円増加の581億1百万円となりました。

純資産は、四半期純利益266億5千7百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当136億8百万円の実施による減少の結果、5,912億1千9百万円となり、また自己資本比率は74.0%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ639億4千5百万円減少し、1,011億4百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない預入期間3ヶ月超の定期預金及び短期投資1,755億円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ84億4千5百万円減少し、2,766億4百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ144億7千6百万円減少の267億1千1百万円となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益392億2千5百万円、未収消費税等の減少106億7千1百万円、減価償却費105億2千3百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額291億2千6百万円、仕入債務の減少101億9千8百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出151億7千5百万円、短期投資の増加額604億9千9百万円により、前年同期の159億8千6百万円に対し724億8千9百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払136億8百万円により、前年同期の3億1千7百万円の収入に対し167億5千万円の支出となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

売上高に関しましては、主力の半導体製造装置部門は変更ないものの、FPD/PV製造装置部門及び電子部品・情報通信機器部門は前回予想に対し、若干下回る見込みとなりました。また、利益面では製品競争力の維持・強化やコスト削減に取り組んだことにより改善する見込みとなりました。これにより、平成23年8月1日に公表した通期の連結業績予想を修正いたします。

平成24年3月期の連結業績予想

	通期予想
売上高	6,300億円 (前年同期比 5.8%減)
半導体製造装置	4,700億円 (前年同期比 8.1%減)
FPD/PV製造装置	715億円 (前年同期比 7.2%増)
電子部品・情報通信機器	880億円 (前年同期比 2.5%減)
その他	5億円 (前年同期比10.3%増)
営業利益	570億円 (前年同期比41.8%減)
経常利益	605億円 (前年同期比40.6%減)
当期純利益	400億円 (前年同期比44.4%減)

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

第1四半期連結会計期間より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日)を適用しております。

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の金額は、186円54銭であります。

3. 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	52,992	53,105
受取手形及び売掛金	136,385	131,253
有価証券	232,057	223,499
商品及び製品	111,918	107,975
仕掛品	43,246	37,410
原材料及び貯蔵品	13,760	13,808
その他	55,024	44,023
貸倒引当金	△1,153	△1,168
流動資産合計	644,231	609,907
固定資産		
有形固定資産	112,551	122,810
無形固定資産		
その他	4,212	4,068
無形固定資産合計	4,212	4,068
投資その他の資産		
その他	50,240	47,695
貸倒引当金	△2,031	△2,013
投資その他の資産合計	48,209	45,681
固定資産合計	164,973	172,560
資産合計	809,205	782,467
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	53,612	41,906
賞与引当金	11,130	10,689
製品保証引当金	7,594	8,179
その他の引当金	675	293
その他	95,024	72,076
流動負債合計	168,038	133,146
固定負債		
退職給付引当金	52,230	53,508
その他の引当金	595	606
その他	3,538	3,987
固定負債合計	56,365	58,101
負債合計	224,403	191,248
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,045	78,023
利益剰余金	457,658	470,653
自己株式	△10,484	△10,018
株主資本合計	580,180	593,618
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,807	882
繰延ヘッジ損益	△12	16
為替換算調整勘定	△10,234	△15,252
その他の包括利益累計額合計	△7,439	△14,352
新株予約権	1,499	1,258
少数株主持分	10,560	10,694
純資産合計	584,801	591,219
負債純資産合計	809,205	782,467

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
売上高	318,400	326,350
売上原価	209,683	212,807
売上総利益	108,717	113,543
販売費及び一般管理費		
研究開発費	34,120	41,148
その他	32,254	35,534
販売費及び一般管理費合計	66,375	76,683
営業利益	42,342	36,859
営業外収益		
為替差益	86	986
その他	2,860	2,109
営業外収益合計	2,947	3,096
営業外費用		
閉鎖拠点維持管理費用	104	68
その他	77	164
営業外費用合計	182	233
経常利益	45,107	39,722
特別利益		
償却債権取立益	—	1,437
貸倒引当金戻入額	309	—
その他	196	184
特別利益合計	506	1,621
特別損失		
災害による損失	—	938
投資有価証券評価損	—	811
その他	564	368
特別損失合計	564	2,118
税金等調整前四半期純利益	45,049	39,225
法人税等	11,193	12,242
少数株主損益調整前四半期純利益	33,856	26,983
少数株主利益	402	325
四半期純利益	33,454	26,657

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	33,856	26,983
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,369	△1,924
繰延ヘッジ損益	173	51
為替換算調整勘定	△4,071	△5,061
その他の包括利益合計	△5,267	△6,935
四半期包括利益	28,588	20,048
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	28,187	19,744
少数株主に係る四半期包括利益	401	303

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	45,049	39,225
減価償却費	7,819	10,523
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,344	1,320
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,853	△359
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	1,662	699
受取利息及び受取配当金	△414	△491
売上債権の増減額 (△は増加)	1,434	2,446
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△31,377	6,013
仕入債務の増減額 (△は減少)	6,785	△10,198
未収消費税等の増減額 (△は増加)	2,512	10,671
未払消費税等の増減額 (△は減少)	21	△2,610
前受金の増減額 (△は減少)	4,827	891
その他	1,133	△2,700
小計	44,653	55,430
利息及び配当金の受取額	446	425
利息の支払額	△18	△18
法人税等の支払額	△3,894	△29,126
営業活動によるキャッシュ・フロー	41,187	26,711
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額 (△は増加)	—	5,000
短期投資の増減額 (△は増加)	80	△60,499
有形固定資産の取得による支出	△13,814	△15,175
その他	△2,253	△1,814
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,986	△72,489
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	1,502	△2,844
配当金の支払額	△1,431	△13,608
その他	247	△297
財務活動によるキャッシュ・フロー	317	△16,750
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,054	△1,416
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	24,463	△63,945
現金及び現金同等物の期首残高	123,939	165,050
現金及び現金同等物の四半期末残高	148,403	101,104

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽電池)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD/PV製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置及び薄膜シリコン太陽電池用のプラズマCVD装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
売上高	248,394	36,677	41,787	7,896	334,754	△8,404	326,350
セグメント利益	50,271	2,932	1,249	994	55,447	△16,221	39,225

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの製品等の輸送、機器等のリース及び保険業務等を含んでおります。
2. セグメント利益の調整額△16,221百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△13,440百万円であります。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。